


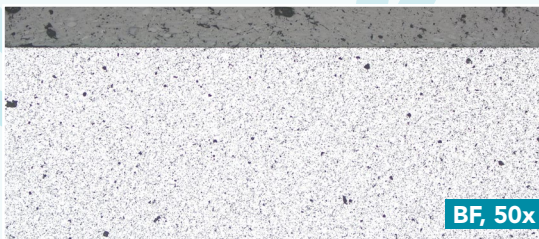


Aka-Brief #12 材料: 700-2000HV

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| 1 |  Piatto 220+ |  水 |  300 RPM |  40 N |  磨平 |  BF, 50x |
| 2 |  Allegran 6 |  DiaUltra 9 μm |  150 RPM |  45 N |  5 min* |  BF, 50x |
| 3 |  Allegran 3 |  DiaUltra 3 μm |  150 RPM |  45 N |  5 min* |  BF, 50x |
| 4 |  Silk |  DiaUltra 1 μm |  150 RPM |  30 N |  5 min* |  BF, 50x |
| 5 |  Chemal** |  Colloidal Silica 50 nm Alkaline |  150 RPM |  20 N |  2 min* |  BF, 50x |

图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

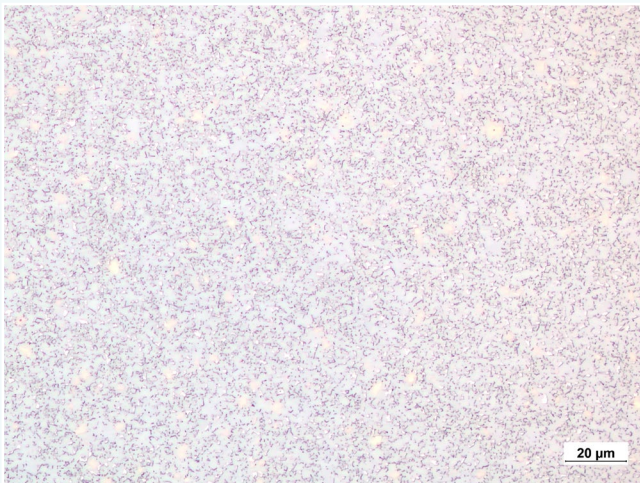
样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

* 根据所有制备的材料样品，可研磨和抛光的时间能需要调整。

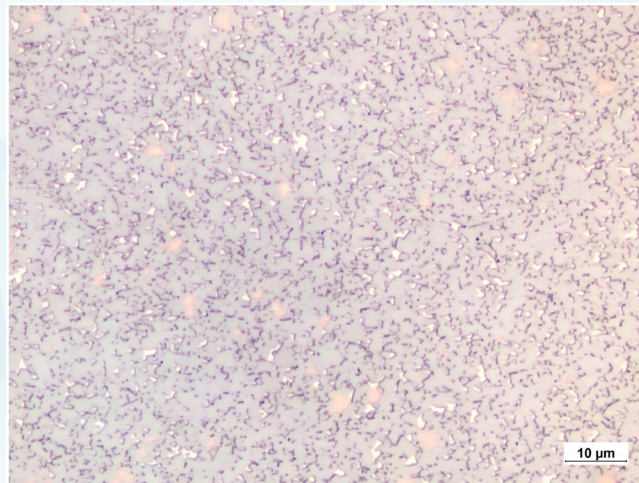
**开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

Aka-Brief #12 材料: 700-2000HV

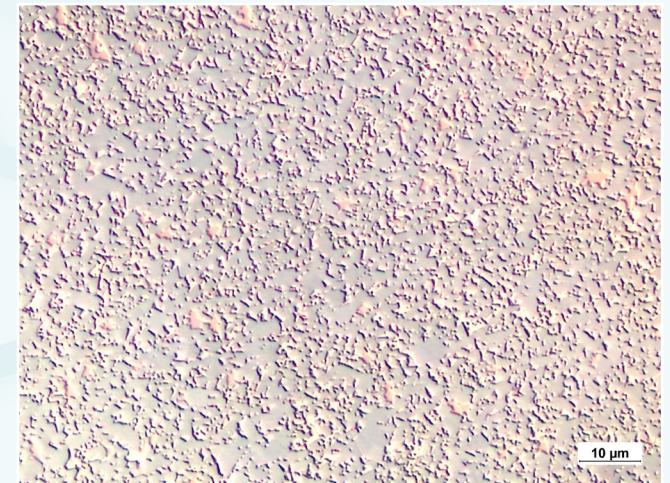
最终制样结果



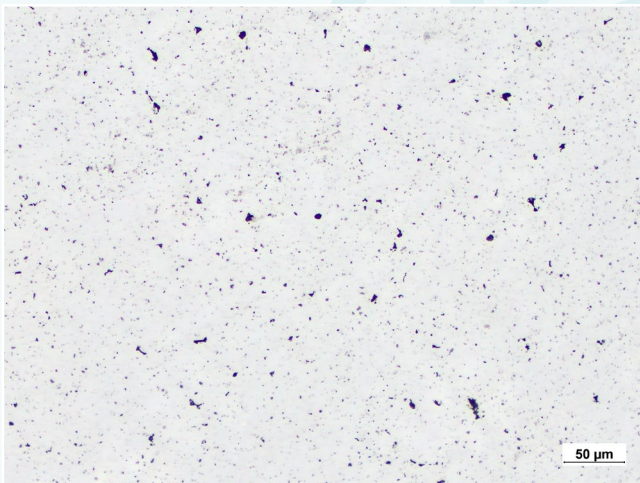
烧结硬质合金，明场像，500倍



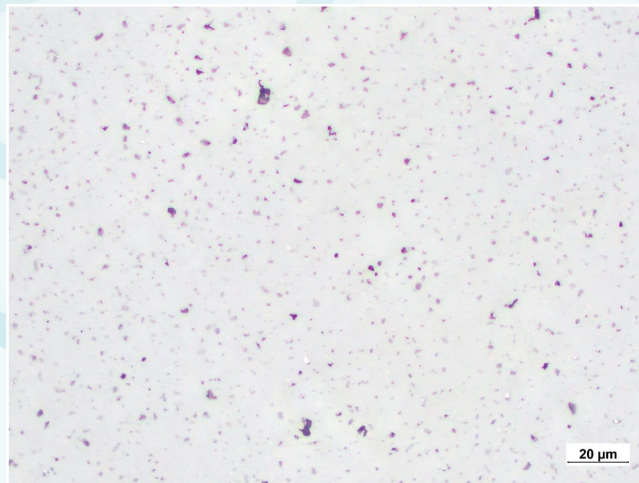
烧结硬质合金，明场像，1000倍



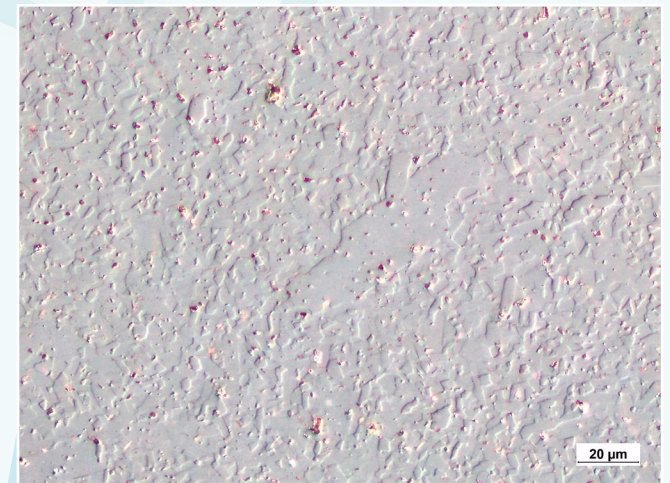
烧结硬质合金，微分干涉衬度像，1000倍



碳化硅，明场像，200倍



碳化硅，明场像，500倍



碳化硅，微分干涉衬度像，500倍